

XF2U

旋转背锁方式 (0.5mm节距 低高度型)

通过旋转背锁方式实现基板上高度0.9mm、深度3.5mm的超小型连接器。

- 全行业最小级别的封装面积，进一步提高基板设计自由度。
- 可有效减少部品数的上、下两面接点方式。
- 适合的FPC厚度t=0.2mm。镀金型。



NEW

■ 额定值/性能

额定电流	AC/DC0.5A
额定电压	AC/DC50V
接触电阻	60mΩ以下 (DC20mV以下、100mA以下)
绝缘电阻	100MΩ以上 (DC250V)
耐电压	AC250V 1min (漏电流1mA以下)
插拔寿命	20次
使用环境温度	-30~+85℃ (无结冰、无结露)

■ 材质/处理

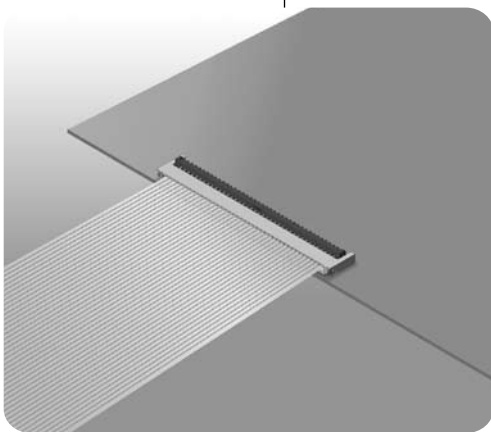
外壳	LCP树脂 (UL94V-0) / 本色
滑触头	LCP树脂 (UL94V-0) / 黑色
接触器	螺钉为铜合金/镍材质 (2μm)、接触部镀金 (0.15μm)
保持向下部	螺钉为铜合金/镀锡 (1.5μm)

〈XF2U型〉低高度0.5mm节距小型FDC连接器的特长

进步1

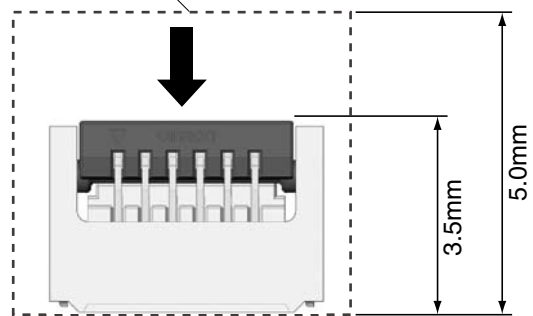
行业最小等级的极板上占有的面积和体积

- ➔ 实现了机械的小型、薄型、和轻量化
可是分装面积缩小30% (与本公司以往比)。



分装面积缩小约30% (与本公司以往产品比)

本公司以往产品



上图为XF2U

进步2

独特的触滑头构造设计安心

- ➔ FPC的安装作业可靠性提高
独特的设计防止了作业时触滑头的破裂和滑脱。

XF2U